

PERTE

Chip

Microelectrónica y Semiconductores



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

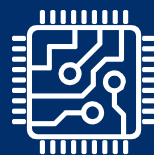


GOBIERNO
DE ESPAÑA

#PlanDeRecuperación

1. INTRODUCCIÓN

OBJETIVO



PERTE CHIP

OBJETIVO

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE LA INDUSTRIA DE MICROELECTRÓNICA Y
SEMICONDUCTORES EN ESPAÑA

IMPACTO

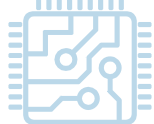
EFECTO MULTIPLICADOR EN EL
CONJUNTO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA



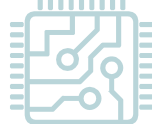
1. INTRODUCCIÓN

ACTIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL PERTE

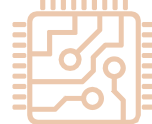
RISC-V



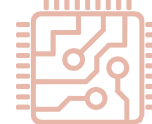
FOTÓNICA
INTEGRADA



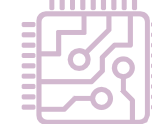
COMPUTACIÓN
CUÁNTICA



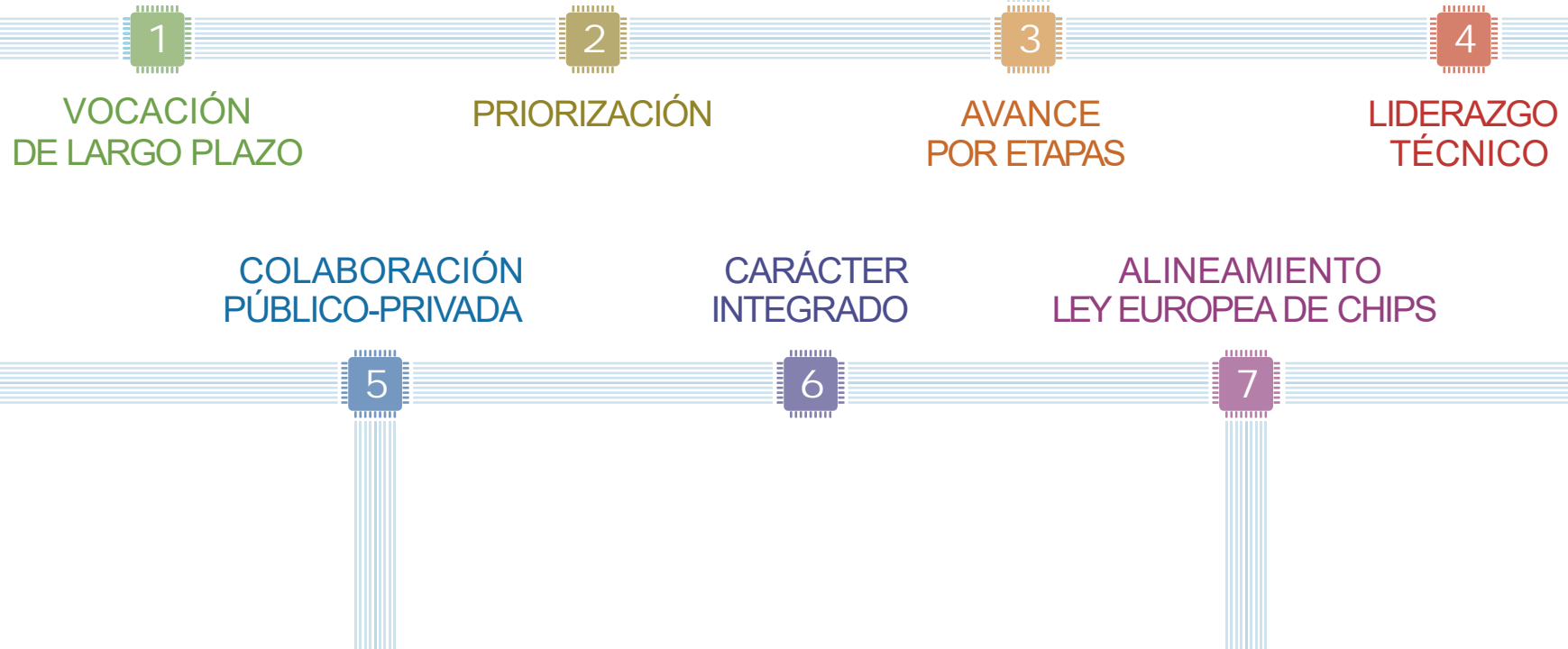
MICRO-
NANOFABS



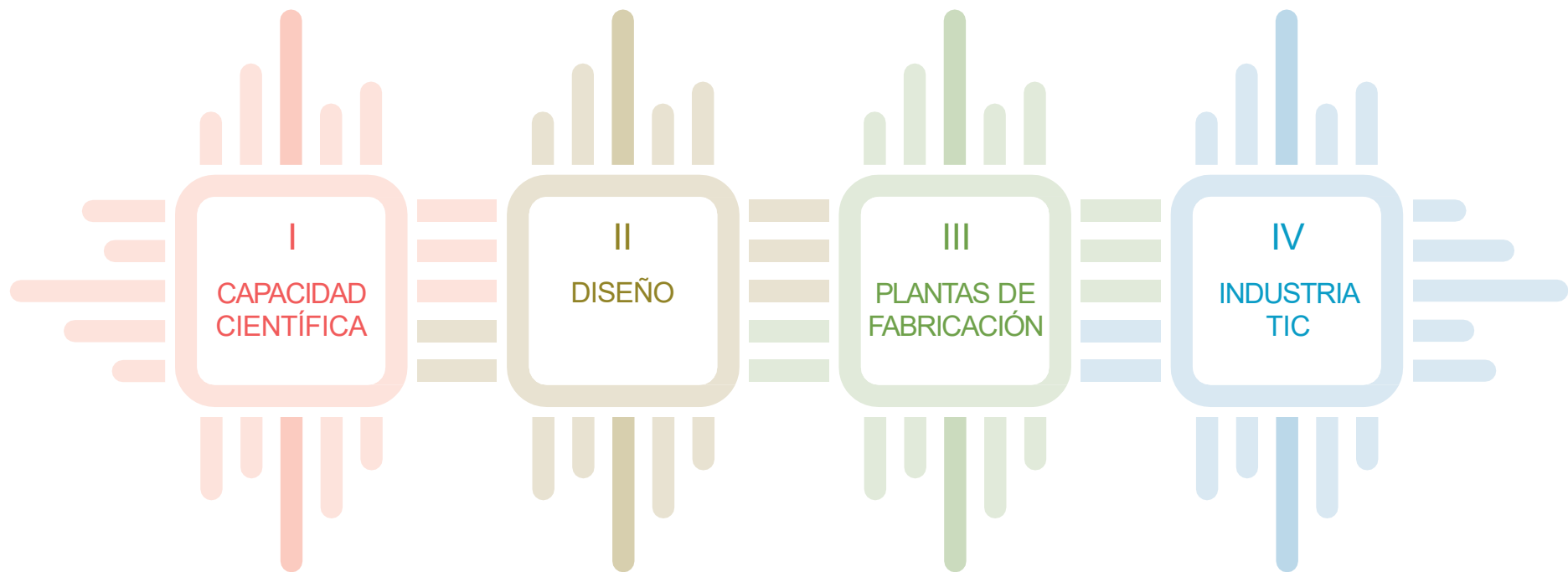
SECTORES
TRACTORES



2. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA SIETE PRINCIPIOS



2. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA CUATRO EJES



3. EJECUCIÓN INSTRUMENTOS (I)

- **Inversiones estratégicas** (front-end, back-end, sustratos, equipos):
 - Subvenciones: Chips Act - FOAK para cubrir hasta el 50% del total de CAPEX.
 - Capital: participación potencial de los socios y/o el Gobierno
- **Proyectos de I+D, incluidas salas blancas**
 - Subvenciones: a través de convocatorias competitivas
 - Inversión directa en infraestructuras públicas
 - Acuerdos de cooperación con terceros
- **Incentivos a la fabricación avanzada**
 - Subvenciones a través de convocatorias competitivas: ayudas de finalidad regional o ayudas a la pyme
 - Préstamos o capital a través del Mecanismo de Financiación PERTE Chip
- **Mecanismo de financiación Chip.**
 - Ofrece una amplia gama de soluciones de financiación
- **Comisionado PERTE Chip**
 - Impulsa, coordina, planifica y apoya

3. EJECUCIÓN INSTRUMENTOS (II)

➤ **Subvenciones: 275 M€ + 1.225 M€ Adenda**

- **Ministerio para la Transformación Digital (C15, C16): 621 + 40 M€**

- Cátedras Chip
- IPCEI – Microelectrónica
- Chips JU: Pilot lines, centros de competencia, plataforma de diseño, proyectos I+D.
- Cuántica



- **Ministerio de Industria y Turismo (C12): 200 M€**

- IPCEI - Microelectrónica



- **Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (C17): 364 M€**

- Misiones Chip CDTI
- Pruebas de Concepto AEI
- Chips JU: Proyectos I+D
- Infraestructura pública (Micronanofabs, CNM...)



3. EJECUCIÓN INSTRUMENTOS (III)

➤ **Créditos: 10.750 M€ Adenda**

Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores

- **Mecanismo de Financiación del PERTE Chip**

- Préstamos (10 años, 3 carencia)
- Préstamos participativos (vinculado a evolución)
- Entrada en capital (minoritaria, 15 años)
- Combinación de lo anterior

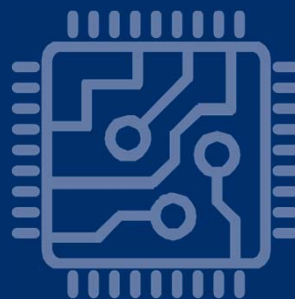
- **Características del Mecanismo**

- Coordinación con otros instrumentos de ayuda pública
- Flexibilidad en las operaciones
- Agilidad, no es una ayuda de estado
- SEMyS ofrece financiación buscando rentabilidad, pero sobre todo la creación de tejido industrial
- Apoyo y experiencia de SEPIDES, tanto en la parte financiera como en la de promoción económica (gestión de suelo, edificios, construcción,...)



MÁS INFORMACIÓN

- **Página web del PERTE CHIP, SEMyS:** anuncios, convocatorias, mapeo del ecosistema, otra información (ES/EN): www.pertechip.com
- **Página web de la Ley Europea de Chips:** Contexto chips act, Chips JU, FOAK,...
- **Página web Chips JU:** Eventos, convocatorias, workshops
- **Plan de Recuperación- PERTE Chip:** memoria, información
- **Componentes Plan de Recuperación (incluida Adenda):** planificación presupuestaria 2023-2026: C12, C15,C16,C17
- **Hitos y Objetivos CID** Adenda plan de recuperación



Gracias

